证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2026-045

希荻微电子集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月7日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月7日 09点00分

召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座（A8）305-308单元

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月7日

至2026年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2	《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3	《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√
4	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
5	《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》	√
6	《关于2025年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
8	《关于公司董事2025年度薪酬确认的议案》	√
9	《关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》	√
10	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届董事会第三十三次会议审议通过。详见分别于2026年4月10日、2026年4月17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案9、议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：作为公司董事的股东以及与公司董事存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688173	希荻微	2026/4/28

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明"股东会"字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间、地点

登记时间：2026年4月29日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）；

登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座（A8）305-308单元

（三）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式

联系地址：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座（A8）305-308单元

联系电话：0757-81280550

联系人：卢海航

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

附件1：授权委托书

授权委托书

希荻微电子集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月7日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
2	《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》			
4	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》			
5	《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》			
6	《关于2025年度利润分配方案的议案》			
7	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》			
8	《关于公司董事2025年度薪酬确认的议案》			
9	《关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》			
10	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2026-043

希荻微电子集团股份有限公司 关于质押全资子公司股权向银行申请并购贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟质押全资子公司深圳市诚芯微科技有限公司（曾用名"深圳市诚芯微科技股份有限公司"，以下简称"诚芯微"）100%的股权为公司向银行申请不超过人民币2.48亿元的并购贷款提供担保。

一、情况概述

公司于2025年12月31日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于现金收购深圳市诚芯微科技股份有限公司100%股份的议案》，同意公司以现金方式收购曹建林、曹松林、深圳市链智创芯管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市汇智创芯管理咨询合伙企业（有限合伙）合计持有的诚芯微100%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易价格参考评估值并经交易各方协商确定，最终确定为31,000.00万元。本次交易完成后，诚芯微将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于以现金方式收购深圳市诚芯微科技股份有限公司100%股份的公告》（公告编号：2026-003）。

公司于2026年1月23日召开第二届董事会第三十次会议，于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金支付部分股权收购款的议案》，同意公司使用部分超募资金6,040.00万元用于支付本次交易部分股权收购款，使用自有资金和/或自筹资金支付剩余股权转让价款24,960.00万元。具体内容详见公司分别于2026年1月24日、2026年2月10日在上海证券交易所网站披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于使用部分超募资金支付部分股权收购款的公告》（公告编号：2026-015）和《希荻微电子集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-021）。

2026年3月20日，本次交易完成交割，自交割日起，诚芯微成为公司的全资子公司。具体内容详见公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于现金收购深圳市诚芯微科技有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2026-029）。

公司于2026年4月16日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于质押全资子公司股权向银行申请并购贷款的议案》。根据公司经营资金需求，公司拟质押全资子公司诚芯微100%的股权为公司向银行申请人民币2.48亿元的并购贷款提供担保，用于支付股权收购对价或置换先行使用自有资金支付的诚芯微股权收购价款。

公司分别于2025年4月22日召开第二届董事会第十九次会议，于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司在2025年度向银行申请合计不超过10亿元人民币或等额10亿元人民币的美元的综合授信额度，授权有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起一年，授信额度在有效期内可循环使用。具体内容详见公司分别于2025年4月23日、2025年5月14日在上海证券交易所网站披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-031）和《希荻微电子集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-042）。公司本次并购贷款的金额在上述年度融资额度范围内。

本次质押全资子公司股权向银行申请并购贷款事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《希荻微电子集团股份有限公司章程》等相关规定，本次质押全资子公司股权向银行申请并购贷款事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

二、本次质押标的公司情况

（一）基本情况

公司名称	深圳市诚芯微科技有限公司
统一社会信用代码	91440300699087014T
注册资本	3026.25万人民币
类型	有限责任公司
法定代表人	郝跃国
成立日期	2009-12-23
住所	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路31号李朗国际珠宝产业园厂房一A3栋601
经营范围	一般经营项目：集成电路、IC、三极管的设计、研发、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事货物及技术进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，不含进口分销）。许可经营项目：无。

（二）标的公司主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日/2025年度（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
资产总额	19,756.31	22,635.52
负债总额	7,078.39	12,372.16
净资产	12,677.93	10,263.36
营业收入	19,666.54	19,746.31
净利润	2,414.56	2,170.89

注：上述诚芯微财务数据为诚芯微合并范围数据。

三、担保协议的主要内容

公司拟质押全资子公司诚芯微100%的股权为公司向银行申请人民币2.48亿元的并购贷款提供担保，用于支付股权收购对价或置换先行使用自有资金支付的诚芯微股权收购价款。本次质押担保事项涉及的债权本金数额、出质股权数额等以具体签署的担保协议为准。

四、对公司的影响

公司通过质押全资子公司诚芯微100%股权为公司向银行申请并购贷款提供担保，是基于本次交易的实际需求采取的融资行为，有利于优化公司融资结构，提升资金使用效率，符合公司整体资金使用计划。目前，公司经营状况稳定，具备良好的偿债能力。本次质押全资子公司股权向银行申请并购贷款事项不会对公司带来重大财务风险，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，亦不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2026-039

希荻微电子集团股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为更加真实、准确地反映希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下：

一、资产减值准备的计提概况

根据《企业会计准则》和公司的相关会计政策，公司对截至2025年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据识别和测试的结果，计提了相关资产的减值准备。2025年，公司对各项资产计提减值准备合计为2,033.26万元，具体情况如下表：

单位：万元

项目	2025年计提金额
信用减值损失	268.68
其中：应收账款坏账损失	-13.95
其他应收款坏账损失	265.30
其他非流动资产坏账损失	17.33
资产减值损失	1,764.58
其中：存货跌价损失	1,764.58
合计	2,033.26

二、资产减值准备计提的具体情况说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备；除上述应收账款外，于每个资产负债表日，公司对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失进行估计。公司考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

经测试，公司2025年计提信用减值损失金额268.68万元。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，于每个资产负债表日，公司的存货按成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

经测试，公司2025年计提资产减值损失金额1,764.58万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备合计2,033.26万元，导致公司2025年合并利润总额减少2,033.26万元（合并利润总额未计算所得税影响）。上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会影响公司正常经营。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2026-037

希荻微电子集团股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十三次会议于2026年4月3日以通讯方式和书面方式发出通知，并于2026年4月16日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长TAO HAI（陶海）先生主持，会议应参加表决的董事为8人，实际参加会议表决的董事为8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《公司章程》以及《希荻微电子集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《审计委员会实施细则》"）等有关规定，公司董事会审计委员会针对2025年度工作内容，形成了《希荻微电子集团股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估的议案》

根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《规范运作》和《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定，公司对会计师事务所2025年度审计过程中的履职情况进行评估，并形成了《希荻微电子集团股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

（五）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《规范运作》和《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所2025年度审计过程中的履职情况进行监督，并形成了《希荻微电子集团股份有限公司审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限公司审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

（六）审议通过《关于2025年度在任独立董事独立性情况评估的议案》

独立董事徐克美、黄澄清、王一鸣回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限公司董事会关于2025年度独立董事独立性的专项评估意见》。

（七）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》以及《规范运作》等相关规定，公司编制了《希荻微电子集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-038）。

（八）审议通过《关于<2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》

为了加强与利益相关方的沟通和联系，回应各方的关切和期望，公司针对公司及其下属子公司在2025年践行ESG理念所做出的努力及取得的绩效，编制了《希荻微电子集团股份有限公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

本议案已经董事会战略与发展委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》及《希荻微电子集团股份有限公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告摘要》。

（九）审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会认为：于内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会认为：公司2025年年度报告及摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2025年年度报告及摘要全面、客观、公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。

经审核，董事会认为：公司2025年年度报告及摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2025年年度报告及摘要全面、客观、公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果。公司全体董事保证公司2025年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限公司2025年年度报告》及《希荻微电子集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

因公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，且充分考虑到公司目前处于快速发展期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定的2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司2025年度利润分配方案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

√适用 □不适用

截至报告期末，公司母公司报表中期末未分配利润为-15,498.47万元。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司不满足实施现金分红的前提条件。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	希荻微	688173	无

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

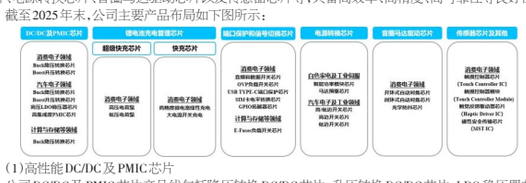
1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢海航	周紫慧
联系地址	佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座（A8）305-308单元（住所申报）	佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座（A8）305-308单元（住所申报）
电话	0757-81280550	0757-81280550
传真	0757-86305776	0757-86305776
电子信箱	ir@halomicro.com	ir@halomicro.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司是国内领先的半导体和集成电路设计企业之一，主营业务为包括电源管理芯片和信号链芯片在内集成电路的研发、设计和销售。公司主要产品为服务于消费类电子和车载电子领域的集成电路，现有产品布局覆盖DC/DC芯片、锂电池充电管理芯片、高集成度PMIC芯片、端口保护和信号切换芯片、电源转换芯片、音圈马达驱动芯片以及传感器芯片等，具备高效率、高精度、高可靠性等良好性能。截至2025年末，公司主要产品布局如下图所示：



（1）高性能DC/DC及PMIC芯片

公司DC/DC及PMIC芯片产品线包括降压转换DC/DC芯片、升压转换DC/DC芯片、LDO稳压器芯片以及高集成度PMIC等系列产品，可以应用于消费电子、汽车电子以及计算与存储等领域，实现业内领先的低功耗特性、卓越的负载瞬态响应能力、高效转换效率及高稳定性表现。

在消费电子领域，公司多款消费级DC/DC芯片较早进入了Qualcomm平台参考设计，各类产品可以为智能手机、可穿戴等移动终端智能电子设备AP、GPU、LPDDR、WiFi模组、摄像头模组、OTG功能、屏幕、硅负极电池等核心单元供电，已广泛应用于三星、小米、vivo、OPPO、联想等品牌客户的消费电子设备中，覆盖包括中高端旗舰机型在内的多款移动终端智能电子设备。2025年，公司推出了多款高效低功耗DC/DC降压转换芯片以满足客户需求。

在汽车电子领域，公司车规级芯片达到了AEC-Q100标准，其中DC/DC芯片进入了Qualcomm智能座舱汽车平台参考设计，已实现了向Joynext、Yura Tech等全球知名的汽车前装厂商出货，并最终应用于奥迪、现代、起亚、小鹏、红旗、问界、长安等中欧日韩多个品牌汽车中。此外，公司高压LDO稳压器芯片和高边开关芯片已实现了向国内多家头部客户批量出货，高低边开关芯片的种类不断丰富。报告期内，公司亦推出了车规级PMIC芯片产品，可以为摄像头模组内MCU、SerDes和图像传感器等提供紧凑、低噪声、高效率的电源管理解决方案。

在计算与存储领域，公司10-20A的POL芯片产品已经在与下游多家客户进行软硬件适配，部分客户将进入量产爬坡阶段。针对20-50A电流范围，公司已有对应的POL芯片和功率模组样品，目前正在与目标客户进行初步联调。未来，公司将推出更大电流和更高集成度电源解决方案，以满足数据中心、AI算力等领域的更高功率需求。

（2）锂电池充电管理芯片

公司锂电池充电管理芯片产品线主要围绕快充芯片和超级快充芯片进行产品布局，细分品类包括线性充电芯片、开关充电芯片、电荷泵充电芯片等系列产品，主要应用于消费电子领域，可以助力移动终端智能电子设备实现高效、快速、安全充电。

中信证券研报显示，凭借充电功率高、系统成本低、兼容性强等优势，电荷泵已成为手机快充的主流方案。公司自主研发的双相充电拓扑结构在大电流充电的情况下实现极小的电压纹波，电荷泵充电管理芯片产品覆盖2:1、4:1和4:2等多种架构，可以支持2C-4C电池快速充电功能，在充电效率、充电功率等方面具有相较海外厂商竞品更良好的表现，且具备更好的电路保护功能和更小的芯片面积。

此外，公司通过围绕市场需求不断推陈出新，帮助客户进一步提升使用体验。报告期内，公司锂电池充电管理芯片已成功导入三星、传音、荣耀、影石等全球知名品牌客户的供应链体系，位列国产电荷泵充电芯片第一梯队供应商。

（3）端口保护及信号切换芯片

公司端口保护及信号切换芯片产品线包括音频和数据开关芯片、SIM卡电平转换芯片、OVP负载开关、USB Type-C端口保护芯片以及GPIO拓展器芯片等系列产品，集成了高压负载开关、输出过压保护、输入欠压保护、过温保护、短路/过流/反向电流保护等功能，赋能移动终端智能电子设备接口转换与安全，广泛应用于以智能手机、笔记本电脑为代表的消费电子领域。

此外，公司推出的E-Fuses负载开关芯片系列产品亦可提供全面的保护功能，包括过载保护、过压保护、过温保护和反向电流阻断等，为消费电子、计算与存储等领域提供高可靠供电保障。

（4）音圈马达驱动芯片

公司音圈马达驱动芯片产品线（即智能视觉感知业务），包括开环式自动对焦芯片（如传统音圈电机驱动芯片和双向音圈电机驱动芯片）、闭环式自动对焦芯片以及光学防抖芯片（如eOIS芯片、SMA OIS芯片以及Folded & C-Zoom OIS芯片）等系列产品。音圈马达驱动芯片可以精确控制音圈马达的运动，驱动摄像头模组内的镜头完成对焦、防抖等系列机械动作，从而保障图像或视频的清晰度与稳定性。

公司于2022年12月与全球知名芯片厂商韩国动运达成合作，获得其自动对焦（AF）及光学防抖（OIS）技术在大中华地区的独占使用权。自2023年第二季度起，公司以自有品牌全面布局智能视觉感知业务。截至2025年末，公司已围绕该产品线搭建了供应链，推动该业务从贸易模式向自产模式转换。同时，公司还组建了专项研发团队，以市场需求为牵引布局下一代产品，通过技术迭代实现产品线在丰富度与性能上的阶梯式升级。

公司与舜宇、欧菲光、正钰微、立景创新等知名模组厂商建立合作，相关产品已进入vivo、荣耀、传音、OPPO、小米、联想、科大讯飞、视源股份等品牌客户的供应链体系，广泛应用于智能手机、学习平板、掌上电脑、视频会议设备等各类移动终端设备。在智能手机摄像头核心部件领域，公司音圈马达驱动芯片凭借技术与规模优势，稳居细分市场头部供应商地位；同时正加速布局运动相机、无人机等新兴摄像头应用场景，持续拓展业务边界以巩固技术引领力与市场竞争力。

（5）传感器芯片及其他

公司于2024年8月完成对韩国芯片设计上市公司Zinitix（303030.KS）控股权的收购，其产品线包括触摸控制器芯片及模组（Touch Controller IC and Module）、触觉反馈驱动器（Haptic Driver IC）、磁性安全传输芯片（Magnetic Security Transmission IC）等。

Zinitix核心产品线为触摸控制器芯片（Touch Controller IC）?，它以传感技术为核心构建，能将触摸输入精准转换为电信号，并通过混合传感技术实现更精准的触摸识别，其搭载高速全通道/多驱动器架构，可与AMOLED、LCD等多种显示面板完美适配，从而满足各类终端电子设备的显示需求。截至2025年末，Zinitix相关产品已导入三星等国际知名品牌的供应链体系，广泛应用于智能手机、智能手表、平板电脑、笔记本电脑等移动及可穿戴设备，成为提升人机交互体验的关键技术支撑。

2.2 主要经营模式

公司采用Fabless经营模式，专注于包括电源管理芯片和信号链芯片在内的模拟集成电路及数模混合集成电路的研发、设计和销售环节，将晶圆制造及封装测试环节委托给相应的代工厂完成。具体而言，公司在芯片产品的研发完成后，将研发成果即集成电路产品布图交付给专业的晶圆代工厂和封测厂，分别委托其进行晶圆制造和封装测试，再将芯片成品直接或通过经销商销售给下游客户。

在Fabless经营模式下，公司有效规避了大规模固定资产投资所带来的财务风险。这使得公司能够更专注于高价值创造的设计开发环节，从而显著提高运行效率，加速新技术和新产品的研发进程，进而提升整体竞争力。在销售环节，公司采用直销和代理经销相结合的销售模式，可有效降低新客户开发的成本，控制应收账款回款风险，并提高公司运作效率和市场响应速度。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所处行业属于集成电路设计行业。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为"信息传输、软件和信息技术服务业"中的"软件和信息技术服务业"中的"集成电路设计"，行业代码"I6520"。近年来，AI（人工智能）、5G通信、物联网、自动驾驶等新兴技术的快速发展，促使集成电路产业不断进行技术创新和产业升级。

1.集成电路行业概况

集成电路（Integrated Circuit，IC）是一种微型电子器件或部件，其采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。

集成电路产业链主要由"设计——制造——封装测试"三个环节构成，集成电路产业是以技术作为核心驱动因素的产业，在设计环节上技术与资本高度密集，是带动整体产业发展的核心因素，也同样是经济附加值最高的环节。集成电路行业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。集成电路产品根据功能主要可分为数字芯片和模拟芯片，其中数字芯片指基于数字逻辑设计和运行的，用于处理数字信号的集成电路芯片，包括微元件、存储器和逻辑芯片